

# 2017-2022年中国半导体材料市场全景调查与市场前景预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2017-2022年中国半导体材料市场全景调查与市场前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/G35327Z4O5.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

2015年全球半导体材料市场产值为434亿美元，其中，台湾为94.1亿美元，连续6年蝉联最大市场；而南韩、中国大陆、北美与欧洲都有微幅成长，日本则出现6.28%的衰退幅度。总的晶圆制造材料和封装材料分别为241亿美元和193亿美元，分别比2014年衰退1%与2%。

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国半导体材料市场全景调查与市场前景预测报告》共十四章。首先介绍了半导体材料产业相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体材料行业规模及消费需求，然后对中国半导体材料行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体材料行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体材料行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一部分 半导体材料行业发展概述

#### 第一章 半导体材料产业基本概念

##### 第一节 半导体材料的概述

###### 一、半导体材料概念

###### 二、半导体材料的分类

###### 三、半导体材料的特点

###### 四、化合物半导体材料介绍

##### 第二节 半导体材料特性和制备

###### 一、半导体材料特性和参数

###### 二、半导体材料制备

### 第二章 2014-2016年半导体材料发展基本概念

#### 第一节 主要半导体材料概况

##### 一、半导体材料的特性和参数

##### 二、半导体材料的种类

##### 三、半导体材料的制备

## 第二节 其他半导体材料的概况

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、GaN材料的特性与应用
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

## 第三章 2014-2016年世界半导体材料产业运行形势综述

### 第一节 2014-2016年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、全球半导体产业新进展
- 四、国际半导体市场增长减缓

### 第二节 2014-2016年主要国家或地区半导体材料行业发展分析

- 一、比利时半导体材料行业分析
- 二、德国半导体材料行业分析
- 三、日本半导体材料行业分析
- 四、韩国半导体材料行业分析
- 五、中国台湾半导体材料行业分析

## 第四章 2014-2016年中国半导体材料产业运行环境分析

### 第一节 2014-2016年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入
- 三、恩格尔系数
- 四、工业发展形势分析
- 五、存贷款利率变化
- 六、财政收支状况

### 第二节 2014-2016年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、《电子信息产业调整和振兴规划》
- 二、新政策对半导体材料业有积极作用
- 三、进出口政策分析

### 第三节 2014-2016年中国半导体材料产业社会环境分析

## 第五章 2014-2016年中国半导体材料行业运行动态分析

### 第一节 2014-2016年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

### 第二节 2014-2016年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲
- 二、应用材料企业进军封装
- 三、新政策对半导体材料业的作用

### 第三节 2014-2016年中国半导体材料发展存在问题分析

## 第六章 2014-2016年中国半导体材料行业技术分析

### 第一节 2014-2016年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导
- 二、有机半导体TFT的应用

### 第二节 2014-2016年半导体材料行业技术动态分析

- 一、功率半导体技术动态
- 二、闪光驱动器技术动态
- 三、封装技术动态
- 四、太阳光电系统技术动态

### 第三节 2017-2022年半导体材料行业技术前景分析

- 一、高效驱动方案前景分析
- 二、计算机芯片技术前景分析
- 三、太阳能产业技术前景分析

## 第七章 2014-2016年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

### 第一节 2014-2016年中国第三代半导体材料相关介绍

- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、第三代半导体材料得到推广
- 三、宽禁带半导体材料

### 第二节 2014-2016年中国氮化镓的发展概况

- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

## 二、氮化镓照亮半导体照明产业

## 三、GaN蓝光产业的重要影响

### 第三节 2014-2016年中国氮化镓的研发和应用状况

#### 一、中科院研制成功氮化镓基激光器

#### 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化

#### 三、非极性氮化镓材料的研究有进展

#### 四、氮化镓的应用范围

#### 五、氮化镓晶体管的应用分析

## 第八章 2014-2016年中国其他半导体材料运行局势分析

### 第一节 砷化镓

#### 一、砷化镓单晶材料的发展

#### 二、砷化镓的特性

#### 三、砷化镓产业的发展应用状况

#### 四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产

### 第二节 碳化硅

#### 一、半导体材料碳化硅介绍

#### 二、碳化硅材料的特性

#### 三、高温碳化硅制造装置的组成

#### 四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

## 第九章 2014-2016年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

### 第一节 2014-2016年中国半导体分立器件制造业数据统计与监测分析

#### 一、2014-2016年中国半导体分立器件制造业企业数量增长分析

#### 二、2014-2016年中国半导体分立器件制造业从业人数调查分析

#### 三、2014-2016年中国半导体分立器件制造业总销售收入分析

#### 四、2014-2016年中国半导体分立器件制造业利润总额分析

#### 五、2014-2016年中国半导体分立器件制造业投资资产增长性分析

### 第二节 2016年中国半导体分立器件制造业最新数据统计与监测分析（按季度更新）

#### 一、企业数量与分布

#### 二、销售收入

#### 三、利润总额

#### 四、从业人数

### 第三节 2016年中国半导体分立器件制造业投资状况监测（按季度更新）

#### 一、业资产区域分布

#### 二、主要省市投资增速对比

## 第十章 2014-2016年中国半导体市场运行态势分析

### 第一节 LED产业发展

#### 一、国外LED产业发展情况分析

#### 二、国内LED产业发展情况分析

#### 三、LED产业所面临的问题分析

#### 四、2017-2022年LDE产业发展趋势及前景分析

### 第二节 集成电路

#### 一、中国集成电路销售情况分析

#### 二、集成电路及微电子组件（8542）进出口数据分析

#### 三、集成电路产量统计分析

#### 四、半导体集成电路产业发展趋势

### 第三节 电子元器件

#### 一、电子元器件的发展特点分析

#### 二、电子元件产量分析

#### 三、电子元器件的消费趋势分析

### 第四节 半导体分立器件

#### 一、半导体分立器件市场发展特点分析

#### 二、半导体分立器件产量分析

#### 三、半导体分立器件发展趋势分析

### 第五节 其他半导体市场

#### 一、半导体气体与化学品产业发展概况

#### 二、IC光罩市场发展概况

#### 三、中国电源管理芯片市场概况

## 第三部分 半导体材料行业竞争分析

### 第十一章 2014-2016年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

#### 第一节 2014-2016年国外年半导体材料行业竞争分析

- 一、2014-2016年欧洲半导体行业竞争机构分析
- 二、2014-2016年欧洲半导体产业竞争分析
- 第二节 2014-2016年我国半导体材料市场竞争分析
  - 一、半导体照明应用市场竞争分析
  - 二、单芯片市场竞争分析
  - 三、太阳能光伏市场竞争分析
- 第三节 2014-2016年我国半导体材料企业竞争分析
  - 一、国内硅材料企业竞争分析
  - 二、政企联动竞争分析

## 第十二章 2014-2016年中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

### 第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第二节 天津中环半导体股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第三节 宁波康强电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析



三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 上海九晶电子材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

#### 四、企业成本费用情况

##### 第十一节 河南新乡华丹电子有限责任公司

###### 一、企业基本概况

###### 二、企业销售收入及盈利水平分析

###### 三、企业资产及负债情况分析

###### 四、企业成本费用情况

#### 第四部分 行业发展前景预测及投资分析

##### 第十三章 2017-2022年中国半导体材料行业发展趋势分析

###### 第一节 2017-2022年中国半导体材料行业市场趋势

###### 一、2017-2022年国产设备市场分析

###### 二、市场低迷创新机遇分析

###### 三、半导体材料产业整合

###### 第二节 2017-2022年中国半导体行业市场发展预测分析

###### 一、全球光通信市场发展预测分析

###### 二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

###### 第三节 2017-2022年中国半导体市场销售额预测分析

###### 第四节 2017-2022年中国半导体产业预测分析

###### 一、半导体电子设备产业发展预测分析

###### 二、GPS芯片产量预测分析

###### 三、高性能半导体模拟器件的发展预测

##### 第十四章 2017-2022年中国半导体材料行业投资咨询分析 (ZY CW)

###### 第一节 2017-2022年中国半导体材料行业投资环境分析

###### 第二节 2017-2022年中国半导体材料行业投资机会分析

###### 一、半导体材料投资潜力分析

###### 二、半导体材料投资吸引力分析

###### 第三节 2017-2022年中国半导体材料行业投资风险分析

###### 一、市场竞争风险分析

###### 二、政策风险分析

###### 三、技术风险分析

###### 第四节 建议

图表目录：

图表：元素半导体的性质与结构

图表： - 化合物半导体的性质

图表： - 化合物半导体的性质

图表：部分二元化合物半导体的性质

图表：CZT薄膜的能隙 $E_g$ 与组分的关系

图表：2014-2016年全球前20名半导体公司排名情况

图表：2014-2016年全球各区域划分各季度对比情况

图表：2014-2016年IC产业产值情况

图表：钐矿GaN和闪锌矿GaN的特性

图表：双气流MOCVD生长GaN装置

图表：GaN基器件与GaAs及SiC器件的性能比较

图表：以发光效率为标志的LED发展历程

图表：非晶型氧化镓铟锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左)

图表：五种基本的印制方式

图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽

图表：软式微影技术的组件制作流程

图表：高分辨率软式微影技术压印头印制 $250\text{nm} \times 250\text{nm}$ 方柱图

图表：由 $100\mu\text{m}$ 玻璃背板及 $30\mu\text{m}$ 聚合物双层模块成具有 $270\text{nm}$ 图案之压印头实例

图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较

图表：主要半导体材料的对比分析

图表：半导体材料的主要用途分析

图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求情况

图表：多晶硅质量指标分析

图表：我国多晶硅产业的发展情况

图表：2014-2016年多晶硅价格走势情况

图表：GaAs单晶生产方法对比情况

图表：世界GaAs单晶主要生产厂家情况

图表：SiC器件的研究情况

图表：中国半导体材料需求量情况

图表：2014-2016年全球前20大半导体供应商情况

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/G35327Z4O5.html>